

# 2.3次元パッケージ用基板 ~i-THOP®~

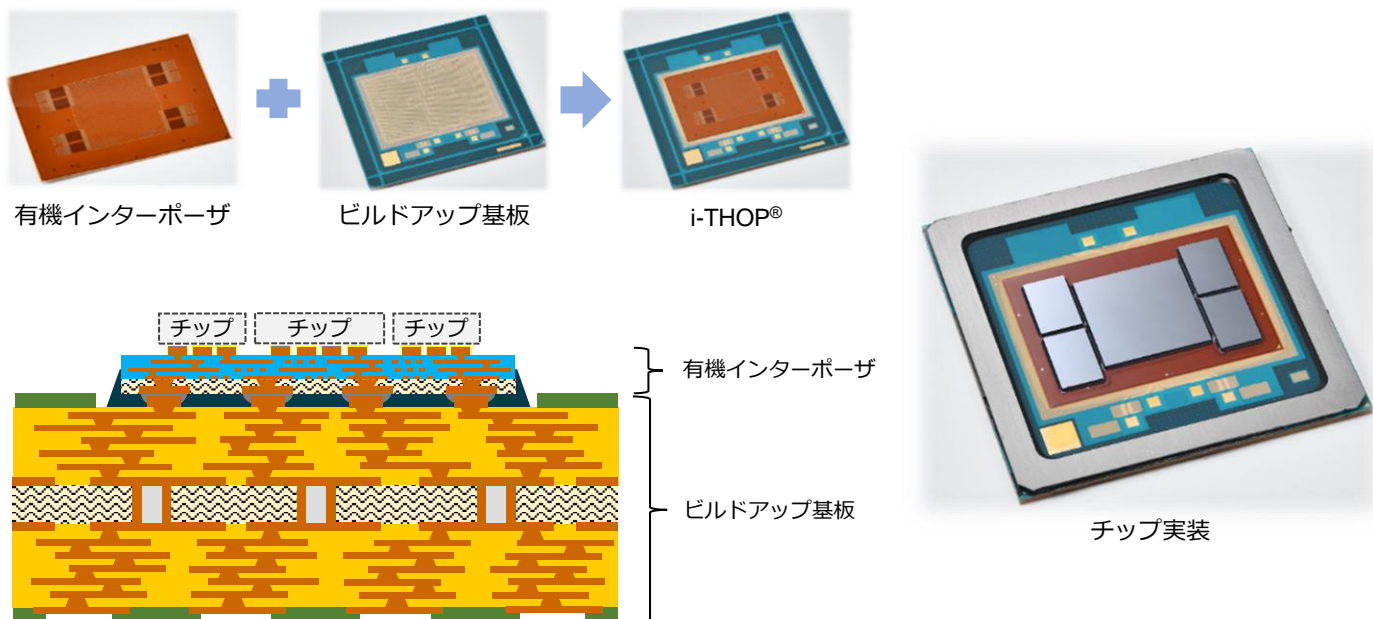
i-THOP (integrated Thin film High density Organic Package : アイソップ)。i-THOPは新光電気工業㈱の登録商標です。

- 開発中 -

## 特徴

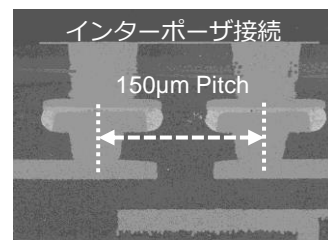
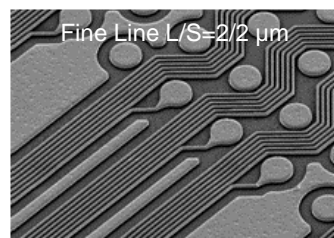
- 有機インターポーザとビルドアップ基板を一体化した高密度配線基板
- インターポーザ部には薄膜技術を適用し、狭ピッチ配線層を形成
- チップレット、異種ICチップ搭載、HBM (High Bandwidth Memory) などの広帯域メモリーチップ搭載などに対応

## 構造



## 技術

有機インターポーザ	
Min. FC (Flip-Chip) Pad Pitch	40 $\mu\text{m}$
Min. Line/Space	2 / 2 $\mu\text{m}$
Micro Via Dia.	12 $\mu\text{m}$
Metal Thickness	2 $\mu\text{m}$
Insulation Thickness	5 $\mu\text{m}$
インターポーザ接続	
Material	Sn-Bi Solder
Solder Joint Pitch	150 $\mu\text{m}$



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

